



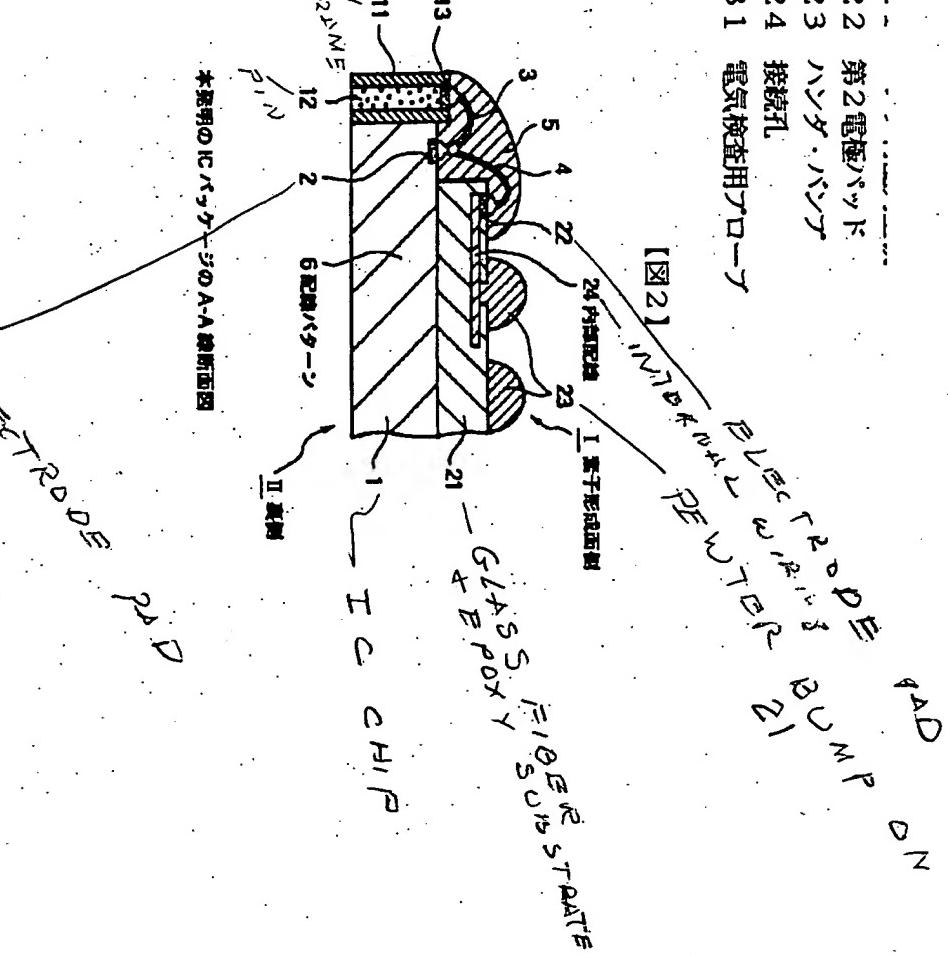
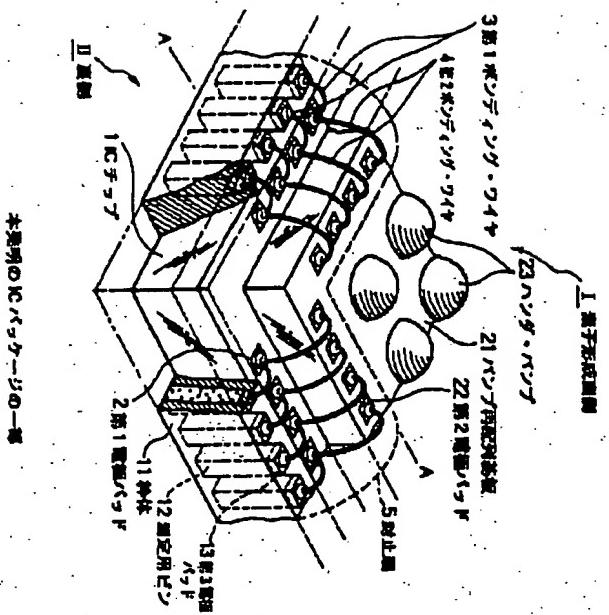
く、ICチップの構成の細部、各部材の寸法、各部材の構成材料については適宜変更や選択が可能である。

[0018]

[発明の効果] 以上の説明からも明らかのように、本発

22 第2電極パッド
23 ハンダ・バンプ
24 接続孔
30 電気検査用プローブ
31 電気検査用プローブ

[図1]



本発明のICパッケージの一例